

DA 150U 绝缘型粘接胶 产品数据表

高热稳定性

优异的耐湿性能

高可靠性

简介

DA 150U 为单组分、热固性、绝缘型固晶胶，专为薄型、低空洞率的大尺寸 GaN 芯片键合应用而设计。该产品具有优异的粘接性能，同时具备良好的耐热性与耐紫外性能，并具有不渗油特性，适用于对可靠性与界面质量要求较高的封装结构。DA 150U 适用于小尺寸及大尺寸芯片的固晶应用，可采用点胶方式进行施胶。产品已在高温回流焊条件下验证其优异的可靠性与工艺稳定性。

物理特性

产品名称	DA 150U 绝缘型粘接胶
化学体系	环氧树脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.08 g/cm ³
粘度	500 – 2,000 cP
固化材料特性	
玻璃化转变温度 Tg	> 100 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	65
导热系数 (W/mK)	> 0.4
剪切强度	2,800 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过
芯片剪切强度	2x2毫米矽晶片(鍍鈀):2.0 2x2毫米鍍金矽晶片(裸銅基 底):2.5 2x2毫米鍍金矽晶片(鍍金基 底):2.3

推荐固化条件

150 °C 固化 30 – 45 分钟

说明：上述固化时间不包含胶层位置升温至目标固化温度所需的时间。可根据具体工艺条件评估并采用其他固化曲线。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下，于原密封包装中储存，保质期为 6 个月。超过该期限储存可能导致材料粘度升高。请防止材料受潮、挥发或混入异物，否则可能对其加工性能产生不利影响。

安全

DA 150U 为环保型、低毒性材料。在操作和使用过程中仍建议遵循常规工业卫生与安全规范。详细安全信息请参阅产品 SDS(安全数据表)。

包装

DA 150U 绝缘型固晶胶提供 10 cc 与 30 cc 标准包装规格。其他包装形式可根据客户需求提供, 具体订购信息请联系 YINCAE。